

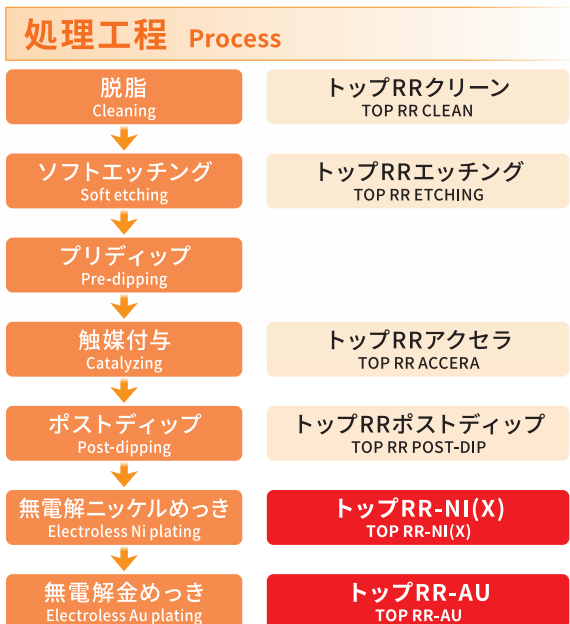
Roll to Roll 装置による連続生産に対応した無電解ニッケル/金めっきプロセス

Electroless Ni/Au Plating Process for FPC Boards to Roll to Roll Plating System

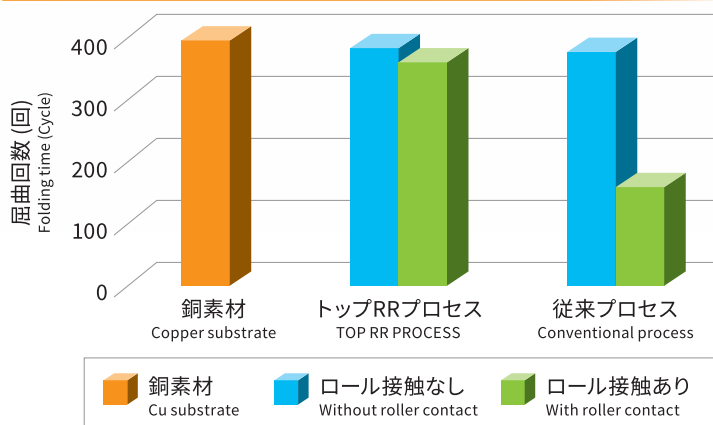
トップRRプロセス

TOP RR PROCESS

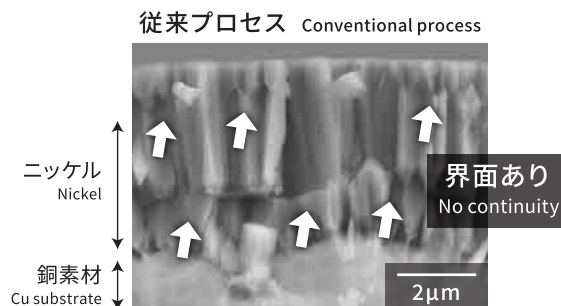
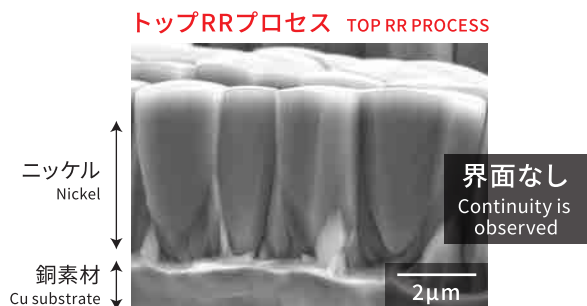
- Roll to Roll 装置を利用して電気銅めっきから無電解ニッケル/金めっきまで連続生産が可能
Continuous production from electro-copper to electroless nickel/gold plating is possible by Roll to Roll plating system
- 搬送時のロールとの接触による不連続析出がなく、耐折性に優れる
Can obtain high deposition power continuously, excellent in folding endurance performance
- 長尺フレキシブル基板へのめっきにも対応可能
Applicable to long-length FPC substrates



搬送の影響を受けない優れた耐折性
No impact by conveyance,
high folding endurance is available



ロール接触においても優れた析出性 Great deposition performance even if rollers contact



自社Roll to Roll装置での試作めっきに対応します Can make prototypes at Okuno's pilot lines



フィルム幅 Film width	最大260mm MAX.
搬送速度 Conveyor speed	0.1~0.9m/分 m/min
槽内ロール径 Roll diameter in a tank	Φ100mm
最大巻径 コア内径 Maximum roll diameter Inner core diameter	Φ400mm 3インチ inch